

看图学技能丛书

看图学

张新德 刘淑华 等编著

集成电路

选用、检测与查用

1000问



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

看图学技能丛书

看图学集成电路选用、 检测与查用 100 问

张新德 刘淑华 等编著



机械工业出版社

全书共分 8 篇，即看图学集成电路基础、看图学集成电路种类与特性、看图学集成电路选用与贮运、看图学集成电路识别、看图学集成电路检测、看图学集成电路典型应用电路、看图学集成电路修配与更换及图表速查集成电路技术资料，共约 100 问。另外，附录中还给出了常用集成电路相关词汇英汉对照，方便读者使用。本书全面介绍了最常用的集成电路基本理论、基础知识、封装形式、选用识别、拆修工具、拆装方法、典型应用、检测修配技巧、更换操作、内部电路原理图和实用特性参数等内容，重点突出集成电路的选用、识别、检测和实用特性参数，是一本集集成电路理论知识、选用技巧、修配操作、检测实践及参数查询于一体的人门类图书。

本书适合集成电路初学人员、自学人员、职业培训学校师生、岗位培训人员、电器维修人员、电器安装人员、电器制作人员、电器销售人员及无线电爱好者阅读和参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

看图学集成电路选用、检测与查用 100 问 / 张新德等编著 . —北京：机械工业出版社， 2010.1

(看图学技能丛书)

ISBN 978-7-111-29103-9

I. 看… II. 张… III. 集成电路—问答 IV. TN4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 212765 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：顾 谦 责任编辑：顾 谦 封面设计：陈 沛

责任校对：陈延翔 责任印制：李 妍

北京振兴源印务有限公司印刷

2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

169mm × 239mm · 18.75 印张 · 375 千字

0001 ~ 3000 册

标准书号： ISBN 978-7-111-29103-9

定价： 33.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心： (010) 88361066

门户网：<http://www.cmpbook.com>

销售一部： (010) 68326294

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售二部： (010) 88379649

封面无防伪标均为盗版

读者服务部： (010) 68993821

前　　言

集成电路已无处不在，其品种多、技术参数复杂。许多初学集成电路的人员急需得到一种以师带徒式的快速、直观、重点突出的集成电路学习与查用资料。此外，还有很多业余集成电路使用、检测人员和新农村建设技术人员，他们都需要集成电路选用、检测与查用方面的入门书籍。鉴于此，我们编写了《看图学集成电路选用、检测与查用 100 问》一书，以满足广大读者的需要。

全书采用“看图学”的方式分篇进行介绍，每一个问答力求解答一个具体的问题，让读者对常用集成电路原理、选用与检测有一个全面具体的了解，具有一定的动手能力，并能通过本书查询到最常用集成电路的特性参数和内部原理图。另外因各厂家资料中所给出的电路图形符号、文字符号等不尽相同，为了便于读者实际应用，本书未做完全统一，请读者谅解。

本书在编写和出版过程中，得到了机械工业出版社领导和编辑的热情支持与帮助，张利平、陈金桂、刘晔、张云坤、王光玉、王娇、刘运和、陈秋玲、刘桂华、张美兰、周志英、刘玉华、张泽宁、刘文初、刘爱兰等同志也参加了本书部分内容的编写、资料收集和整理等工作，值此成书之际，向这些领导、编辑、参编者和同仁一并表示深情致谢！

由于作者水平有限，书中错漏之处在所难免，还请广大读者批评指正。

作　　者

目 录

前言

| | |
|-------------------------------|----|
| 第1篇 看图学集成电路基础 | 1 |
| 【问答1】 什么是集成电路？ | 1 |
| 【问答2】 集成电路型号如何命名？ | 2 |
| 【问答3】 什么是模拟集成电路？ | 16 |
| 【问答4】 什么是数字集成电路？ | 16 |
| 【问答5】 什么是集成运算放大器？ | 17 |
| 【问答6】 什么是555时基集成电路？ | 17 |
| 【问答7】 什么是稳压集成电路？ | 18 |
| 【问答8】 什么是伴音系统集成电路？ | 19 |
| 【问答9】 什么是行场扫描集成电路？ | 20 |
| 【问答10】 什么是图像中频放大、视频放大集成电路？ | 20 |
| 【问答11】 什么是PAL制彩色解码集成电路？ | 20 |
| 【问答12】 什么是厚膜集成电路？ | 20 |
| 【问答13】 什么是微处理器集成电路？ | 21 |
| 【问答14】 什么是MPU？ | 22 |
| 【问答15】 什么是MCU？ | 22 |
| 【问答16】 什么是遥控集成电路？ | 23 |
| 【问答17】 什么是音响系统集成电路？ | 23 |
| 【问答18】 什么是语音集成电路？ | 24 |
| 【问答19】 什么是霍尔集成电路？ | 24 |
| 【问答20】 什么是声光集成电路？ | 25 |
| 【问答21】 什么是电子琴集成电路？ | 25 |
| 【问答22】 什么是逻辑门集成电路？ | 26 |
| 【问答23】 什么是组合逻辑集成电路？ | 28 |
| 【问答24】 什么是时序逻辑集成电路？ | 29 |
| 【问答25】 什么是D/A转换器？ | 30 |
| 【问答26】 什么是A/D转换器？ | 31 |
| 【问答27】 什么是电压比较器？ | 32 |
| 第2篇 看图学集成电路种类与特性 | 34 |
| 【问答1】 集成电路如何分类？ | 34 |
| 【问答2】 集成电路有哪些常用参数，其含义是什么？ | 39 |
| 【问答3】 CMOS集成电路有哪些常用参数，其含义是什么？ | 40 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 【问答 4】 接口集成电路有哪些常用参数，其含义是什么？ | 43 |
| 【问答 5】 集成运算放大器主要技术特性有哪些？ | 47 |
| 第 3 篇 看图学集成电路选用与贮运 | 49 |
| 【问答 1】 选用集成电路时有哪些原则？ | 49 |
| 【问答 2】 选用集成电路时应注意哪些事项？ | 49 |
| 【问答 3】 如何选用集成稳压器？ | 50 |
| 【问答 4】 集成稳压器选用时需注意哪些事项？ | 51 |
| 【问答 5】 如何选用集成运算放大器？ | 51 |
| 【问答 6】 选用集成运算放大器前需了解哪些性能指标？ | 52 |
| 【问答 7】 如何选用 D/A 转换器？ | 52 |
| 【问答 8】 如何选用 A/D 转换器？ | 53 |
| 【问答 9】 使用集成运算放大器时应注意哪些事项？ | 53 |
| 【问答 10】 如何使用普通三端稳压块制作稳压器？ | 54 |
| 【问答 11】 使用三端可调稳压块制作稳压器时需注意哪些事项？ | 54 |
| 【问答 12】 使用 A/D 转换器时应注意哪些事项？ | 55 |
| 【问答 13】 使用 TTL 集成电路时应注意哪些事项？ | 55 |
| 【问答 14】 使用 CMOS 集成电路时应注意哪些事项？ | 56 |
| 【问答 15】 集成电路运输及贮存时应注意哪些事项？ | 58 |
| 第 4 篇 看图学集成电路识别 | 60 |
| 【问答 1】 如何识别集成电路常用符号？ | 60 |
| 【问答 2】 如何识别单列直插式集成电路引脚？ | 65 |
| 【问答 3】 如何识别单列曲插式集成电路引脚？ | 66 |
| 【问答 4】 如何识别双列直插式集成电路引脚？ | 66 |
| 【问答 5】 如何识别圆形金属外壳集成电路引脚？ | 67 |
| 【问答 6】 如何识别扁平封装集成电路？ | 68 |
| 【问答 7】 如何识别 BGA 封装集成电路？ | 72 |
| 【问答 8】 如何识别集成电路引脚功能符号？ | 74 |
| 【问答 9】 如何识别数字集成电路引脚功能符号？ | 75 |
| 【问答 10】 如何识别模拟集成电路引脚功能符号？ | 80 |
| 【问答 11】 如何识别接口集成电路引脚功能符号？ | 81 |
| 【问答 12】 如何识别 CMOS 集成电路引脚功能符号？ | 83 |
| 第 5 篇 看图学集成电路检测 | 86 |
| 【问答 1】 判断集成电路好坏的方法有哪些？ | 86 |
| 【问答 2】 集成电路的检测方法有哪些？ | 86 |
| 【问答 3】 检测集成电路时应注意哪些事项？ | 88 |
| 【问答 4】 如何检测微处理器集成电路？ | 89 |
| 【问答 5】 如何检测单片机？ | 90 |
| 【问答 6】 如何检测开关电源集成电路？ | 91 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 【问答 7】 判断厚膜块质量好坏有哪些方法? | 92 |
| 【问答 8】 如何检测开关电源厚膜块? | 92 |
| 【问答 9】 如何检测集成运算放大器? | 92 |
| 【问答 10】 如何检测 555 时基集成电路? | 94 |
| 【问答 11】 如何检测音频功率放大集成电路? | 96 |
| 【问答 12】 如何检测固定型三端稳压器? | 96 |
| 【问答 13】 如何检测可调型三端稳压器? | 97 |
| 【问答 14】 如何检测四端稳压器? | 99 |
| 【问答 15】 如何检测数字集成电路? | 100 |
| 第 6 篇 看图学集成电路典型应用电路 | 103 |
| 【问答 1】 时基集成电路的典型应用电路是怎样的? | 103 |
| 【问答 2】 开关电源厚膜集成电路的典型应用电路是怎样的? | 103 |
| 【问答 3】 离线式开关电源电流模式控制器的典型应用电路是怎样的? | 104 |
| 【问答 4】 开关稳压器控制电路的典型应用电路是怎样的? | 105 |
| 【问答 5】 集成运算放大器的典型应用电路是怎样的? | 105 |
| 【问答 6】 耳机立体声前置功率调速集成电路的典型应用电路是怎样的? | 105 |
| 【问答 7】 三端稳压器的典型应用电路是怎样的? | 106 |
| 【问答 8】 四端稳压器的典型应用电路是怎样的? | 107 |
| 【问答 9】 CMOS 低压差稳压器的典型应用电路是怎样的? | 107 |
| 【问答 10】 低功率低压差电压调节器的典型应用电路是怎样的? | 107 |
| 【问答 11】 电流模式降压型 DC-DC 变换器的典型应用电路是怎样的? | 108 |
| 【问答 12】 电流模式同步 PWM 降压变换器的典型应用电路是怎样的? | 108 |
| 【问答 13】 升压型 DC-DC 变换器的典型应用电路是怎样的? | 109 |
| 【问答 14】 同步 PWM 控制器的典型应用电路是怎样的? | 109 |
| 【问答 15】 同步推挽 PWM 控制器的典型应用电路是怎样的? | 110 |
| 【问答 16】 视频解码集成电路的典型应用电路是怎样的? | 110 |
| 【问答 17】 音频处理集成电路的典型应用电路是怎样的? | 112 |
| 【问答 18】 音频功率放大集成电路的典型应用电路是怎样的? | 112 |
| 【问答 19】 A/D 转换器的典型应用电路是怎样的? | 113 |
| 【问答 20】 D/A 转换器的典型应用电路是怎样的? | 113 |
| 【问答 21】 LED 驱动器的典型应用电路是怎样的? | 114 |
| 【问答 22】 电动机驱动集成电路的典型应用电路是怎样的? | 115 |
| 【问答 23】 语音集成芯片的典型应用电路是怎样的? | 115 |
| 第 7 篇 看图学集成电路修配与更换 | 117 |
| 【问答 1】 检修集成电路需要哪些工具与耗材? | 117 |
| 【问答 2】 拆卸集成电路有哪些方法? | 129 |
| 【问答 3】 如何焊接集成电路? | 131 |
| 【问答 4】 如何焊接扁平封装集成电路? | 132 |

| | |
|--|------------|
| 【问答5】 如何焊接BGA封装集成电路，需要哪些工具？ | 134 |
| 【问答6】 如何拆卸贴片集成电路？ | 137 |
| 【问答7】 集成电路拆卸与焊接时需要哪些工具？如何使用它们？ | 138 |
| 【问答8】 如何代换集成电路？ | 140 |
| 第8篇 图表速查集成电路技术资料 | 144 |
| 【问答1】 彩电常用集成电路及其详细技术资料有哪些？ | 144 |
| (1) 24LC21A | 144 |
| (2) 24C64 | 144 |
| (3) 24LC65 | 145 |
| (4) 74HC123 | 145 |
| (5) 74LS04 | 146 |
| (6) AD9883 | 146 |
| (7) AN5285K | 148 |
| (8) AT24C08 | 149 |
| (9) CAT24C64 | 149 |
| (10) CXA1545AS | 149 |
| (11) CXP750096 | 150 |
| (12) DSC90CF383 | 152 |
| (13) FLI2200 | 154 |
| (14) FSCQ0765RT、FSCQ1265RF、FSCQ1565RT、FSCQ1565RP | 156 |
| (15) HCF4066 | 156 |
| (16) HEF4053 | 157 |
| (17) HIC1016 | 157 |
| (18) KA1M0680R | 158 |
| (19) KA5Q1265RF | 159 |
| (20) KA78R15 | 159 |
| (21) KS88C4504 | 160 |
| (22) L7805 | 163 |
| (23) LA7846 | 164 |
| (24) LM2576T-ADJ | 164 |
| (25) M37270MF-168SP | 164 |
| (26) MC44608 | 166 |
| (27) NJW1168 | 167 |
| (28) PW113 | 167 |
| (29) STR-6654 | 172 |
| (30) STR-S6709A | 172 |
| (31) STR-W6856 | 172 |
| (32) TA7508P | 173 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| (33) TDA16846 | 174 |
| (34) TMP87CS38N | 175 |
| (35) TOP223PN | 175 |
| 【问答 2】 电磁炉常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 176 |
| (1) FSD200 | 176 |
| (2) GMS87C1202 | 176 |
| (3) HD74LS145 | 178 |
| (4) HMS87C1104A | 178 |
| (5) HT46R47 | 179 |
| (6) LM339 | 180 |
| (7) MC80F0204 | 180 |
| (8) SN8P1706 | 182 |
| (9) SPMC65P2404A | 182 |
| (10) TA8316AS | 183 |
| (11) THX201 | 184 |
| (12) VIPer12A | 184 |
| 【问答 3】 空调器常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 185 |
| (1) 24C01 | 185 |
| (2) 74LS164 | 185 |
| (3) HCF4001BE | 186 |
| (4) HT46R232 | 186 |
| (5) IR2411 | 187 |
| (6) KA7805 | 189 |
| (7) L78LR05 | 189 |
| (8) LM358 | 190 |
| (9) M54566P | 190 |
| (10) MB89F202 | 191 |
| (11) MC34064 | 192 |
| (12) MC68HC908JK8 | 193 |
| (13) NCP1200P60 | 193 |
| (14) PS21867 | 194 |
| (15) TMP88CK49N | 195 |
| (16) ULN2003 | 198 |
| (17) μPD75028 | 198 |
| 【问答 4】 手机常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 200 |
| (1) AD6426 | 200 |
| (2) ADP3402 | 203 |
| (3) AWT6106 | 204 |

| | |
|---|------------|
| (4) CX77133 | 204 |
| (5) LMX2512 | 205 |
| (6) LRS1341、LRS1342 | 206 |
| (7) PCF5077T | 207 |
| (8) PF08107B | 207 |
| (9) RDA6216 | 209 |
| (10) RF3163 | 209 |
| (11) S1M8656A | 210 |
| (12) Si4113 | 212 |
| (13) SKY74137 | 212 |
| (14) TQM7M4014 | 214 |
| (15) TRF3702 | 214 |
| (16) UAA3535HL | 215 |
| 【问答 5】 微波炉常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 217 |
| (1) 74LS373 | 217 |
| (2) 74LS393 | 217 |
| (3) 74LS74 | 218 |
| (4) ADC0832 | 218 |
| (5) AN6652 | 219 |
| (6) HD404052 系列、HD404054 系列、HD404092 系列、HD404094 系列 | 219 |
| (7) SH69P26 | 220 |
| (8) TMP87C846N | 222 |
| 【问答 6】 洗衣机常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 223 |
| (1) AN7805 | 223 |
| (2) MB89P475 | 224 |
| (3) MC1413P | 226 |
| (4) MC68HC908AB32 | 226 |
| (5) TDA1085 | 227 |
| (6) TMP87CH46 | 228 |
| 【问答 7】 显示器常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 229 |
| (1) 24C04 | 229 |
| (2) AD9884A | 230 |
| (3) BIT3106 | 232 |
| (4) CA1391E | 233 |
| (5) CXA8071P | 234 |
| (6) CXD9529S - LHX | 235 |
| (7) DP104C | 236 |
| (8) FA13842 系列、FA13843 系列、FA13844 系列、FA13845 系列 | 236 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| (9) FSDM0565R | 236 |
| (10) KA2142 | 236 |
| (11) KA2S0680 | 238 |
| (12) KA3842 | 238 |
| (13) LM2437 | 238 |
| (14) MC44604 | 240 |
| (15) TDA4860 | 241 |
| (16) TDA4866 | 241 |
| (17) TDA9302H | 242 |
| (18) TEA1504 | 242 |
| (19) TL494 | 242 |
| (20) WT60P1 | 243 |
| 【问答 8】 其他小家电常用集成电路及其详细技术资料有哪些? | 244 |
| (1) HT45R34 | 244 |
| (2) HT45R36 | 246 |
| (3) HT45R38 | 247 |
| (4) HT45RM03 | 248 |
| (5) HT46RU22 | 250 |
| (6) HT46RU25 | 251 |
| (7) HT48R062、HT48C062 | 253 |
| (8) MB89P485 | 254 |
| (9) NE556 | 256 |
| (10) MAX1551、MAX1555 | 257 |
| 附录 常用集成电路相关词汇英汉对照表 | 258 |

第1篇 看图学集成电路基础

【问答1】 什么是集成电路？

集成电路又称集成块，其英文为 Integrated Circuit，图 1-1 所示为集成电路实物图，在电路中用字母“IC”（或用字母“N”）表示。它是在电子管、晶体管的基础上发展起来的一种微型电子器件或部件。常用集成电路的电路符号如图 1-2 所示。

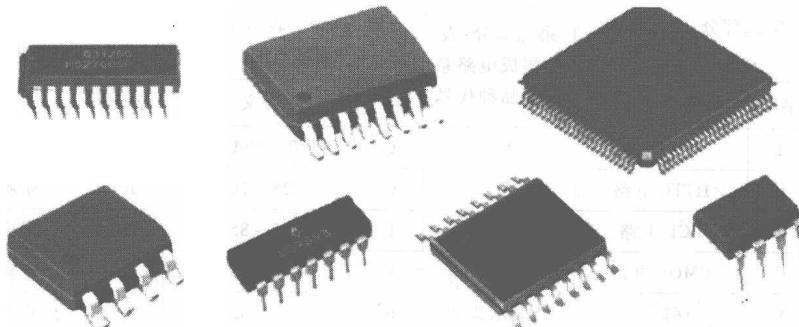


图 1-1 集成电路实物图

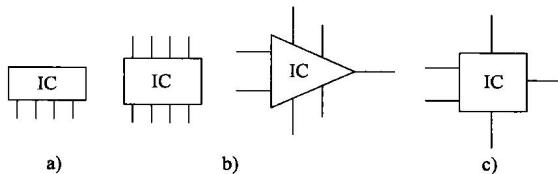


图 1-2 常用集成电路的电路符号

a) 单列集成电路的电路符号 b) 双列集成电路的电路符号 c) 四列集成电路的电路符号

集成电路是在同一块半导体材料上，采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构，形成一个完整的电路，且整个电路的体积大大缩小，引出线和焊接点的数目也大为减少，从而使电子组件向着微型化、小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。

集成电路（IC）的诞生，使电子技术出现了巨大的变革，不但为现代电子技

术和计算机的发展打下了基础，而且标志着微电子技术进入了一个新的发展阶段。1958年9月12日，基尔比研制出世界上第一块集成电路，成功地实现了把电子器件集成在一块半导体材料上的构想，集成电路取代了晶体管，为开发电子产品的各种功能铺平了道路，并且大幅度地降低了成本，使微处理器的出现成为了可能，开创了电子技术历史的新纪元。

【问答2】 集成电路型号如何命名？

1. 国标 GB/T 3430—1989 半导体集成电路型号命名方法

国标 GB/T 3430—1989 半导体集成电路的型号由五部分组成，其型号命名方法见表 1-1。

表 1-1 国标 GB/T 3430—1989 半导体集成电路型号命名方法

| 第一部分： 表示中国 制造 | 第二部分：表示集成 电路类型 | | 第三部分：表 示集成电路系 列和品种代号 | 第四部分：表示工作 温度范围 | | 第五部分：表示器件的 封装形式 | |
|---------------------|-------------------|---------|--|-------------------|------------|--------------------|----------|
| | 字母 | 含义 | | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 |
| 用字母 C 表示中国 制造 | T | TTL 电路 | 用数字或数 字与字母混 合表示集成 电路的序号， 其中 TTL 分为： 54/74XXX、 54/74HXXX、 54/74LXXX、 54/74SXXX、 54/74LSXXX、 54/74ASXXX、 54/74ALSXXX、 54/FXXX； CMOS 分为： 4000 系列、 54/74HCXXX、 54/74HCTXXX | C | 0 ~ 70℃ | F | 多层陶瓷扁平 |
| | H | HTTL 电路 | | G | -25 ~ 70℃ | B | 塑料扁平 |
| | E | ECL 电路 | | L | -25 ~ 85℃ | H | 黑瓷扁平 |
| | C | CMOS 电路 | | E | -40 ~ 85℃ | D | 多层陶瓷双列直插 |
| | M | 存储器 | | R | -55 ~ 85℃ | J | 黑瓷双列直插 |
| | U | 微型机电路 | | M | -55 ~ 125℃ | P | 塑料双列直插 |
| | F | 线性放大器 | | | | S | 塑料单列直插 |
| | W | 稳压器 | | | | T | 金属圆壳 |
| | D | 音响、电视电路 | | | | K | 金属菱形 |
| | B | 非线性电路 | | | | C | 陶瓷芯片载体 |
| | J | 接口电路 | | | | E | 塑料芯片载体 |
| | AD | A/D 转换器 | | | | G | 网格针栅阵列 |
| | DA | D/A 转换器 | | | | | |
| | SC | 通信专用电路 | | | | | |
| | SS | 敏感电路 | | | | | |
| | SW | 钟表电路 | | | | | |
| | SJ | 机电仪电路 | | | | | |
| | SF | 复印机电路 | | | | | |

第一部分：中国制造（用字母 C 表示），表示该集成电路为中国制造，符合国家标准。

第二部分：器件类型（用字母表示），表示集成电路类型。

第三部分：器件系列和品种代号（用数字或数字与字母混合表示），表示集成电路的系列和品种代号。

第四部分：工作温度范围（用字母表示），表示集成电路温度范围。

第五部分：器件封装（用字母表示），表示集成电路的封装形式。

2. 国外集成电路型号的命名方法

国外集成电路型号尚无统一标准，各制造厂商都有自己的一套命名方法，下面将列举出一部分国内市场常见的国外集成电路型号的命名方法。

(1) 美国先进微器件(AMD)公司集成电路型号的命名方法

美国AMD公司集成电路的型号由五部分组成，其型号命名方法见表1-2。

表1-2 美国AMD公司集成电路型号的命名方法

| 第一部分：表示AMD首标 | 第二部分：表示集成电路类型 | | 第三部分：表示集成电路的封装形式 | | 第四部分：表示集成电路分档和工作温度范围 | | 第五部分：表示集成电路的类别 | |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| | 字母或数字 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | | |
| 用字母AM表示美国AMD公司制造 | L | 低功耗 | C、D | 铜焊双列直插 (多层陶瓷) | C | 商用,温度 0~70℃或 0~75℃ | 标有字母B的为已老化的 产品。注意, 没有标志的为 标准加工产品 | |
| | S | 肖特基 | P、R | 塑料双列直插 | | | | |
| | LS | 低功耗肖特基 | F | 扁平(陶瓷扁平) | M | 军用,温度 -55~125℃ | | |
| | 21 | MOS存储器 | X | 管芯 | H | 商用,温度 0~110℃ | | |
| | 25、54、 74 | 中规范(MSI) | A | 塑料球栅阵列 | I | 工业用,温度 -40~85℃ | | |
| | | | B | 塑料芯片载体 | N | 工业用,温度 -25~85℃ | | |
| | 26 | 计算机接口 | J | 塑料芯片载体 (PLCC) | K | 特殊军用,温度 -30~125℃ | | |
| | 27 | 双极存储器或 EPROM | L | 陶瓷芯片载体 (LCC) | L | 限制军用, 温度-55~85℃, 低于125℃ | | |
| | | | V、M | 薄的四面引脚扁平 | | | | |
| | 28 | MOS存储器 | E | 薄的小引脚 | | | | |
| | 29 | 双极微处理器 | G | 陶瓷针栅阵列 | | | | |
| | 60、61、 66 | 模拟,双极 | Z、Y、 U、K、 H | 塑料四面引脚 扁平 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 79 | 电信 | S | 塑料小引脚 | | | | |

(续)

| 第一部分：表示 AMD 首标 | 第二部分：表示集成电路类型 | | 第三部分：表示集成电路的封装形式 | | 第四部分：表示集成电路分档和工作温度范围 | | 第五部分：表示集成电路的类别 |
|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|----|---|
| | 字母或数字 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | |
| 用字母 AM 表示美国 AMD 公司制造 | 80 | MOS 微处理器 | W | 芯片 | | | 标有字母 B 的为已老化的 产品。注意， 没有标志的为 标准加工产品 |
| | 81、82 | MOS 和双极 外围电路 | | 也用别的厂家的符号 | | | |
| | 90 | MOS | P | 塑料双列 | | | |
| | 91 | MOS RAM | NS、N | | | | |
| | 92 | MOS | JS、J | 密封双列 | | | |
| | 93 | 双极逻辑存储器 | W | 扁平 | | | |
| | 94 | MOS | R | 陶瓷芯片载体 | | | |
| | 95 | MOS 外围电路 | A | 陶瓷针栅阵列 | | | |
| | 1004、 104 | ECL 存储器 | NG | 塑料四面引脚 扁平 | | | |
| | 98 | EEPROM | Q、QS | 陶瓷双列 | | | |
| | 99 | CMOS 存储器 | PAL | 可编程逻辑阵列 | | | |

第一部分：AMD 首标（用字母 AM 表示），表示该集成电路为美国 AMD 公司制造。

第二部分：器件编号（用字母或数字表示），表示集成电路类型。

第三部分：器件封装（用字母表示），表示集成电路的封装形式。

第四部分：分档和工作温度范围（用字母表示），表示集成电路分档和工作温度范围。

第五部分：分类（用字母表示），表示集成电路的类别。

(2) 美国模拟器件 ADI 公司集成电路型号的命名方法

美国 ADI 公司集成电路的型号由六部分组成，其型号命名方法见表 1-3。

第一部分：ADI 首标（用字母表示），表示该集成电路为美国 ANA 公司制造。

第二部分：器件编号（用数字表示），表示集成电路的类型。

第三部分：附加说明（用字母表示），表示集成电路的类别。

第四部分：工作温度范围（用字母表示），表示集成电路工作温度范围。

第五部分：器件封装（用字母表示），表示集成电路的封装形式。

第六部分：筛选水平（用数字加字母表示），表示集成电路的工艺级别。

(3) 美国仙童半导体公司 (FSC) 公司集成电路型号的命名方法

美国 FSC 公司集成电路的型号由四部分组成，其型号命名方法见表 1-4。

表 1-3 美国 ADI 公司集成电路型号的命名方法

| 第一部分：表示 ADI 首标 | | 第二部分：表示集成电路的类别 | | 第三部分：表示集成电路的工作温度范围 | | 第四部分：表示集成电路的封装形式 | | 第六部分：表示集成电路的工艺级别 |
|----------------|------------|----------------|----|--------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------|
| 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | |
| AD | 模拟器件转换器 | 用数字表示集成电路类型 | A | 第二代产品 | I、J、K、 L、M | 0 ~ 70°C | E | 芯片载体 |
| HA | 混合 A/D 转换器 | | DI | 介质隔离产品 | | | F | 陶瓷扁平 |
| HD | 混合 D/A 转换器 | | Z | 工作在 12V 电压下的产品 | A、B、C S、T、U | -25 ~ 85°C -55 ~ 125°C | G | PGA(针栅阵列) |
| | | | E | ECL | | | H | 金属圆壳气密 |
| | | | | | | | M | 金属壳双列密封计算机部件 |
| | | | | | | | N | 塑料双列直插 |
| | | | | | | | Q | 陶瓷浸渍双列(黑陶瓷) |
| | | | | | | | D | 陶瓷或金属气密双列(多层陶瓷) |
| | | | | | | | CHIPS | 单片的芯片 |
| | | | | | | | | |

表 1-4 美国 FSC 公司集成电路型号的命名方法

| 第一部分：表示 FSC 首标 | | 第二部分：表示集成电路的封装形式 | | 第三部分：表示集成电路的分档和温度范围 | | |
|----------------|----------|------------------|----|------------------------|----|--|
| 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | |
| μA | 线性电路 | 用数字表示集成电路的类型 | D | 密封陶瓷双列(多层陶瓷双列) | M | 军用, 温度 -55 ~ 125°C |
| F | 仙童(快捷)电路 | | S | 混合电路金属(陶瓷双列, F6800 系列) | L | MOS 电路, -55 ~ 85°C ; 混合电路, -20 ~ 85°C |
| SH | 混合电路 | | E | 塑料圆壳 | V | 工业用, 温度 -20 ~ 85°C 、 -40 ~ 85°C |
| | | | F | 密封扁平(陶瓷扁平) | | |
| | | | H | 金属圆壳 | C | 商用, 温度 0 ~ 70°C 或 0 ~ 75°C (CMOS, -40 ~ 85°C) |
| | | | J | 铜焊双列(TO-66) | | |
| | | | K | 金属功率(TO-3)(金属菱形) | | |
| | | | P | 塑料双列直插 | | |
| | | | R | 密封陶瓷 8 引脚双列 | | |
| | | | T | 塑料 8 引脚双列直插 | | |
| | | | U | 塑料功率(TO-220) | | |
| | | | U1 | 塑料功率 | | |

(续)

| 第一部分：表示 FSC 首标 | | 第二部分：表示集成电路的封装形式 | | 第三部分：表示集成电路的分档和温度范围 | |
|----------------|----|------------------|-----------|---------------------|----|
| 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 |
| | | W | 塑料(TO-92) | | |
| | | SP | 细长的塑料双列 | | |
| | | SD | 细长的陶瓷双列 | | |
| | | L | 陶瓷芯片载体 | | |
| | | Q | 塑料芯片载体 | | |
| | | S | 小外形集成电路 | | |

第一部分：FSC 首标（用字母表示），表示该集成电路为美国 FSC 制造。

第二部分：器件编号（用数字表示），表示集成电路的类型。

第三部分：器件封装（用字母表示），表示集成电路的封装形式。

第四部分：分档和工作温度范围（用字母表示），表示集成电路分档和温度范围。

注意，该公司与 NSC（美国国家半导体公司）合作，专门生产数字集成电路。除原有的 54TTL/74TTL、HTTL、STTL、LSTTL、ASTTL、ALSTTL 和 FAST 等外，还有 CMOS 的 FACT，内含 54AC/74AC、ACT、ACQ、ACTQ 和 FCT 等系列。

(4) 美国英特尔 (INL) 公司集成电路型号的命名方法

美国 INL 公司集成电路的型号由六部分组成，其型号命名方法见表 1-5。

第一部分：器件系列（用字母表示），表示集成电路的系列。

第二部分：器件编号（用数字表示），表示集成电路的序号。

第三部分：器件特性（用字母表示），表示集成电路的特性。

第四部分：工作温度范围（用字母表示），表示集成电路的工作温度范围。

第五部分：器件封装（用字母表示），表示集成电路的封装形式。

第六部分：外引线数（用字母表示），表示集成电路的外引线数。

注意，对于第二部分，首位数 6 表示 CMOS 工艺、数 7 表示 MOS 工艺，第 2 位数 1 表示处理单元、数 3 表示 ROM、数 4 表示接口单元、数 5 表示 RAM、数 6 表示 PROM，第 3 位和第 4 位数表示芯片型号；对于第六部分，V 表示 8（引线径为 0.2in）、W 表示 10（引线径为 0.23in）、Y 表示 8（引线径为 0.2in，4 端与外壳连接）、Z 表示 10（引线径为 0.23in，5 端与外壳连接）。

(5) 美国摩托罗拉 (MOTA) 公司集成电路型号的命名方法

美国 MOTA 公司集成电路的型号由三部分组成，其型号命名方法见表 1-6。